

2018年度精密工学会春季大会学術講演会講演募集について

1. 期 日 平成30年3月15日(木)～17日(土)
2. 会 場 中央大学 後楽園キャンパス(東京都文京区春日1-13-27)
3. 講演申込開始 平成29年11月 6日(月)9時から
4. 講演申込締切 平成29年11月27日(月)17時まで
5. 講演論文原稿締切 平成30年 1月 8日(月)24時まで
6. 講演申込費締切日 平成30年 2月28日(水)までにお納め下さい。
7. 講演論文公開予定 平成30年 3月 1日(木)(講演論文集CD-ROM発行日)

8. 登壇資格

1) 個人会員(正会員・学生会員・学生会員Web級・名誉会員)、賛助会員所属の非個人会員および非会員・学生非会員の方の登壇が可能です。なお今大会より「精密工学会春秋大会 賛助会員参加無料券」での講演申込も可能となりました。

※「精密工学会春秋大会 賛助会員参加無料券」は賛助特級AA～1級までの賛助会員企業に配布しているもので、詳しくは精密工学会ホームページ内の入会案内ページ(<http://www.jspe.or.jp/join/>)をご覧ください。

2) 登壇者を代表として申し込んでいただきますが、講演論文原稿での著者の順番はこれに従う必要はありません。

9. 講演申込について

1) 登壇者のお名前でご受け付けます。講演に必要な費用の請求、郵送物の送付は登壇者に行います。また、WEBへのアクセスも登壇者に限りますので、お申込後にやむを得ず登壇者を変更される場合は、必ずご連絡をお願いいたします。

2) 講演申込は、すべて精密工学会ホームページから行っていただきます。講演申込締切期日を厳守してください。締切後直ちにプログラム編成を行いますので、遅れたものは理由を問わず受け付けません。なお、精密工学会ホームページには講演募集に関する最新情報を掲載します。

3) 申込先 <http://www.jspe.or.jp/> (精密工学会ホームページ)
(問合せ先) 公益社団法人 精密工学会 大会係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-9 九段誠和ビル2階
電話: 03-5226-5191 E-mail: jspe_taikai@jspe.or.jp

4) 講演申込は1件につき1通登録してください。

5) 講演申込には下記の費用が必要です(費用はすべて税込)。

6) 非会員または学生非会員の方で、個人会員としての登壇を希望される場合は、講演申込の受付期間中に会員入会手続きをお願いいたします。講演申込の受付締切後にご入会された場合、登壇者の会員区分の変更はお受けできません。予めご了承ください。

※2018年度春季大会より下記金額に改定となりましたのでご了承の程よろしくをお願いいたします。

登壇者会員区分	申込件数	大会参加登録費(税込)	備考
正会員	1件目	11000円	登壇者の大会参加登録費、講演論文集CD-ROM、アブストラクト集含む
	2件目以降	無料	同一登壇者が2件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。
学生会員・学生会員Web級	1件目	5000円	登壇者の大会参加登録費、講演論文集CD-ROM、アブストラクト集含む

	2 件目以降	無料	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。
賛助会員に所属する非個人会員	1 件目	11000 円	登壇者の大会参登録加費，講演論文集 CD-ROM，アブストラクト集含む
	2 件目以降	無料	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。
非会員	1 件目	24000 円	登壇者の大会参加登録費，講演論文集 CD-ROM，アブストラクト集含む
	2 件目以降	無料	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。
学生非会員	1 件目	11000 円	登壇者の大会参加登録費，講演論文集 CD-ROM，アブストラクト集含む
	2 件目以降	無料	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。

送金方法：現金書留・郵便振替・銀行振込

郵便振替：00180-3-6115 公益社団法人精密工学会

銀行振込：みずほ銀行 九段支店 普通預金 口座番号 8047788 公益社団法人精密工学会

7) 講演論文原稿は、PDF 原稿の書き方を参考に作成し、原稿締切日までに指定の WEB ページから提出してください。原稿締切日を過ぎた講演論文原稿は受理できませんので、期日厳守にてお願いいたします。

8) 講演論文原稿および口頭発表に用いる言語は日本語または英語といたします。

9) 講演論文集 CD-ROM に収録された論文の著作権およびアブストラクト集に掲載される概要の著作権は公益社団法人精密工学会に帰属します。著作権には複製権、翻案権、翻訳権を含みます。

10. 講演申込の方法

1) 講演申込は、精密工学会ホームページでフォームに沿って登録して下さい。

2) 同一題目の第 1 報～第 n 報には必ず副題を入れてください。

3) 講演要旨はそのままアブストラクト集に収録します。講演要旨には図表は掲載できません。研究内容が把握できるわかりやすい文章を 200 字以内で書いてください。

4) 講演希望セッションについて

今大会における講演セッションについては、一覧表（別紙）の通りです。申し込みの際は一覧表を確認の上、講演希望セッション名を選択してください。講演希望セッションの選択ミスがありますとご希望のセッションにまわりません。また、講演申込締切日を過ぎてからの講演希望セッションの変更はできませんので、申込内容を必ず確認いただきますようお願いいたします。

11. プログラムについて

プログラム編成は、その編成権を学术交流委員会がもち、また責任をもって行います。その結果、ご希望のセッションとは異なるセッションでの発表になることがありますので、予めご承知おきください。また、プログラムは原則として変更できません。

12. 講演発表に関するお願いと注意

1) 同一講演者（同一登壇者）が同一テーマ種別で 3 件以上の講演はご遠慮ください。

2) 同一題目で 3 件以上の講演はご遠慮ください。

3) 講演で使用可能な機器はプロジェクタです。パソコンは各自でご持参ください。設定・調整は各講演の

セッション開始前をお願いします。パソコン不良に伴う講演トラブルについては、登壇者の責任で対処していただくようお願いします。

1 3. 登壇者変更および講演申込の取消について

1) 講演申込時の題目・登壇者の変更は原則として認めません。やむを得ず変更される場合は、必ずご連絡をお願いいたします。ご連絡のない場合は、講演申込時の題目・登壇者情報をプログラムに記載いたします。

2) 講演申込締切日を過ぎての申込キャンセルは原則として認めません。必ず講演論文を提出し発表を行っていただきます。 登壇者が病気や事故等のやむを得ない理由で発表出来ない場合は、連名者が代わりに発表するものとします。この点については、講演申込の前に、連名者に必ずご確認ください。

1 4. ベストプレゼンテーション賞の授賞について

特に優れた講演発表について「ベストプレゼンテーション賞」を登壇者にお出しします。本賞は35歳までの若手登壇者を審査対象（キーノートスピーカを除く）として、講演総数の概ね10%に贈賞いたします。

発表当日に、①研究の新規性・発表内容、②発表の構成・方法、③適切な質疑応答、の3項目についてセッション座長および審査員1名（計2名）で採点を行い、その集計結果と講演論文内容を参考として、事業部会学术交流委員会で最終選考いたします。受賞者には選考終了後、表彰状をお送りいたします。

詳細につきましては、精密工学会ホームページ（<http://www.jspe.or.jp/>）に掲載していますのでご覧ください。

<分類表> ※2018年度春季大会より以下の分類に変更となりました。

A：設計・生産システム

B：精密加工

C：メカトロニクス・精密機器

D：精密計測

E：人・環境工学

F：材料・表面プロセス

G：バイオエンジニアリング

H：ナノテクノロジー・新領域

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
A	01	OS	形状モデリングの基礎と応用	大竹 豊(東京大), 金井 崇(東京大)	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス
A	02	OS	デジタルスタイルデザイン	小林 一也(富山県立大), 青山 英樹(慶應義塾大)	意匠設計(スタイルデザイン), リバーズエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術
A	03	OS	持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング	高田 祥三(早稲田大), 梅田 靖(東京大), 増井 慶次郎(産総研)	持続可能社会, ライフサイクル設計, ライフサイクルマネジメント, サステナブル・マニュファクチャリング
A	04	OS	サイバーフィールド構築技術	石川 貴一郎(日本工業大), 増田 宏(電気通信大), 伊達 宏昭(北海道大)	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術(画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援
A	05	OS	オープン指向のCAD/CAM開発	浅川 直紀(金沢大), 乾 正知(茨城大), 金子 順一(埼玉大), 高杉 敬吾(金沢大)	CAD, CAM, CAE, CAT, オープン開発, カーネル内製化
A	06	OS	金型設計・生産技術	村田 泰彦(日本工業大), 植原 弘之(九州工業大), 新川 真人(岐阜大), 福島 祥夫(埼玉工業大)	金型CAD/CAM/CAE, 金型加工, プラスチック成形加工, 塑性加工
A	07	OS	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用	林 朗弘(九州工業大), 青村 茂(首都大), 山本 雅人(北海道大)	群知能, 進化と学習, マルチエージェント, 複雑システム
A	08	OS	システムのシナシス(設計・サービス・生産システム)	下村 芳樹(首都大), 岩村 幸治(大阪府立大), 千葉 龍介(旭川医科大), 妻屋 彰(神戸大), 野間口 大(大阪大), 藤井 信忠(神戸大), 森永 英二(大阪大)	設計プロセス, 設計手法, 設計教育, 設計モデル, 設計評価, サービス設計, PSS(Product-Service Systems), 製品サービスシステム, 設計論, 設計知識, 最適化, ロバスト設計, 信頼性設計, QFD(Quality Function Development), DFX(Design for X), プロダクトファミリー, VR(Virtual Reality)応用, 生産システム, 生産計画, 工程計画, サプライチェーン, 生産シミュレーション, スマートファクトリー
A	99	一般	設計・生産システム一般		
B	01	OS	工作機械の高速高精度化	千田 治光(オークマ), 松原 厚(京都大), 森本 喜隆(金沢工業大), 白瀬 敬一(神戸大)	工作機械, 高速化, 高精度化, 高機能化
B	02	OS	高能率・高精度化のための切削工具	臼杵 年(東京大), 新谷 一博(金沢工業大), 關谷 克彦(広島大), 笹原 弘之(東京農工大)	切削工具, 切削加工技術, 切削特性
B	03	OS	多軸制御加工計測	森重 功一(電気通信大), 竹内 芳美(中部大), 茨木 創一(広島大)	多軸制御, 加工, 計測, 精度補正
B	04	OS	穴加工および穴形状精度の測定	甲木 昭雄(九州大)	穴加工, 穴精度測定, 掘削
B	05	OS	超音波振動を援用した加工技術	磯部 浩巳(長岡技科大), 神 雅彦(日本工業大)	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨
B	06	OS	研削現象とその機構	大橋 一仁(岡山山), 山田 高三(日本大)	研削現象, 研削機構, 加工計測, 研削シミュレーション
B	07	OS	超砥粒ホイール応用加工技術の新展開	田辺 実(明治大), 市田 良夫(CBN&Dナノ加工研究所), 太田 稔(京都工芸繊維大), 澤 武一(芝浦工業大)	超砥粒ホイール, ツルーイング・ドレッシング, 研削盤, 超砥粒ホイール応用加工技術
B	08	OS	曲面・微細形状の超精密加工と計測	山形 豊(理化学研), 森田 晋也(東京電機大), 古城直道(関西大), 林 偉民(群馬大), 柿沼 康弘(慶應義塾大), 鈴木 浩文(中部大)	曲面・微細加工, 超精密加工, 超精密計測
B	09	OS	ナノ表面研削/ELID研削	大森 整(理化学研), 林 偉民(群馬大), 伊藤 伸英(茨城大), 上原 嘉宏(理化学研), 水谷 正義(東北大)	ナノ精度, 鏡面研削, ELID研削
B	10	OS	切断加工	坂本 智(横浜国立大), 諏訪部 仁(金沢工業大)	切断, スライシング, ダイシング, 割断
B	11	OS	砥粒加工の新展開	榎本 俊之(大阪大)	ポリッシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持
B	12	OS	複合研磨	郷 艶華(宇都宮大), 川久保 英樹(信州大), 赤上 陽一(秋田県産技), 西田 均(富山高専)	磁場・電場援用研磨(加工), 電気・磁気粘性流体利用加工
B	13	OS	プラナリゼーションCMPとその応用	森永 均(フジミインコーポレーテッド), 黒河 周平(九州大), 畷田 道雄(金沢工業大)	プラナリゼーションCMP, 超精密研磨, 半導体材料, 消耗材技術(スラリー・パッド・コンディショナー), 装置化技術, デバイスプロセス, 評価技術, ラッピング・ポリッシング, 鏡面・平坦化加工(含む研削), 複合・援用研磨, 新研磨・仕上げ加工法, その他
B	14	OS	電気エネルギー応用加工	早川 伸哉(名古屋工業大), 金子 健正(長岡高専)	放電加工, 電解加工, レーザ加工
B	15	OS	レーザー加工	田辺 里枝(長岡技科大), 古本 達明(金沢大), 岡本 康寛(岡山山)	レーザー加工, レーザ, 微細加工, 材料加工
B	16	OS	エンドミル加工技術	安齋 正博(芝浦工業大), 松村 隆(東京電機大), 吉川 浩一(九州工業大)	エンドミル加工, 切削機構, 切削性能, 切削シミュレーション

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
B	17	OS	機能形状創製 (付加製造, 3Dプリンティング, MI)	新野 俊樹(東京大)	付加製造, 3Dプリンティング, MID
B	18	OS	次世代基盤研磨技術の創成	須田 聖一(静岡大), 赤上 陽一(秋田県産技セ), 久保 百司(東北大)	次世代研磨技術, 砥粒開発, 数値解析, 副資材開発, 砥粒再生技術
B	99	一般	精密加工一般		
C	01	OS	精密・超精密位置決め	佐藤 海二(豊橋技術科学大), 若園 賀生(ジェイテクト), 佐藤 隆太(神戸大)	位置決め, 制御, 機構, センサ
C	02	OS	次世代センサ・アクチュエータ	森田 剛(東京大), 古谷 克司(豊田工業大), 岩附 信行(東京工業大),	圧電アクチュエータ, 超磁歪アクチュエータ, 熱変形アクチュエータ, 高分子アクチュエータ
C	03	OS	ロボティクス	杉 正夫(電気通信大), 関 啓明(金沢大), 金森 哉史(電気通信大)	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ
C	04	OS	メカトロニクス	佐々木 健(東京大)	
C	05	OS	マイクロ生産機械システム	木村 広幸(湘南工科大), 岡崎 祐一(産総研), 長谷 亜蘭(埼玉工業大)	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立, 生産システムの小型化
C	99	一般	メカトロニクス・精密機器一般		
D	01	OS	光応用技術・計測	大谷 幸利(宇都宮大), 稲 秀樹(キヤノン), 石丸 伊知郎(香川大), 藤垣 元治(福井大), 水谷 康弘(大阪大)	光応用技術(三次元計測, 形状計測, 光センシング, 生体・医用計測, 高速度計測, 機器光学, オプトメカトロニクス), イメージング・光情報処理(光イメージング, デジタルオブティクス, 光物性), 光学新領域(プラズモン, テラヘルツ, X線, 中赤外等も含む)
D	02	OS	知的精密計測	高増 潔(東京大), 笹島 和幸(東京工業大), 高谷 裕浩(大阪大), 清水 裕輔(東北大)	知的計測
D	03	OS	画像技術と産業システム応用	小室 孝(埼玉大), 川西 亮輔(三菱電機)	画像処理, 画像応用, 産業システム, 実利用, 知能化システム
D	04	OS	X線光学のための精密技術	松山 智至(大阪大), 湯本 博勝(高輝度光科学研究セ)	X線光学系, X線イメージング, X線CT, X線非破壊検査装置, X線分析装置, X線リングファイ, X線検出器, X線顕微鏡, X線望遠鏡
D	99	一般	精密計測一般		
E	01	OS	医用・人間工学	佐久間 一郎(東京大), 垣本 映(職能開発総合大), 太田 裕治(お茶の水女子大)	医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器
E	02	OS	生産原論	伊藤 昌樹(関東職能開発大), 伊藤 伸英(茨城大), 河西 敏雄(埼玉大/河西研磨技術特別研究室), 池野 順一(埼玉大)	技術者倫理, 生産哲学, モノづくり, 技術史, 工学教育, 技術伝承, 感性
E	99	一般	人・環境工学一般		
F	01	OS	表面処理・機能薄膜	垣内 弘章(大阪大), 井上 尚三(兵庫県立大), 安武 潔(大阪大), 大竹 尚登(東京工業大)	表面処理技術, 薄膜形成, 機能薄膜, 表面特性
F	02	OS	プラズマ加工・材料プロセス	須崎 嘉文(香川大), 大参 宏昌(大阪大)	ドライエッチング, 材料合成, 物質変換, 材料改質, ガス改質, 新規プラズマ応用技術, プラズマ計測, プラズマシミュレーション
F	99	一般	材料・表面プロセス一般		
G	01	OS	マイクロニードル(作製法とアプリケーション)	青柳 誠司(関西大), 榎谷 和義(東海大) 金 範峻(東京大), 加藤 暢宏(近畿大)	マイクロニードル, ニードルアレイ, ニードルパッチ, 無痛針, MEMS, 微細加工, 医療応用
G	02	OS	バイオ・医療への応用展開	初澤 毅(東京工業大), 柴田 隆行(豊橋技科大), 早瀬 仁則(東京理科大), 金子 新(首都大), 青柳 誠司(関西大), 榎谷 和義(東海大), 藤井 輝夫(東京大)	生体分子・細胞マニピュレーション, 生体分子・細胞機能解析, バイオイメージング, バイオアセンブリ, 細胞培養, バイオマテリアル, バイオ機能表面, バイオデバイス, バイオMEMS, マイクロTAS, 医用センサ, 医用マイクロメカニズム, 微細加工, 3Dバイオプリンティング
G	99	一般	バイオエンジニアリング一般		
H	01	OS	マイクロ・ナノ加工とその応用	比田井 洋史(千葉大), 川堰 宣隆(富山県工技セ), 金子 新(首都大), 角田 陽(東京高専), 清水 淳(茨城大)	微細加工, 超精密加工, 表面機能とその評価, トライボロジー
H	02	OS	マイクロ/ナノシステム	中里 裕一(日本工業大), 伊藤 高廣(九州工業大), 松井 伸介(千葉工業大), 寺田 英嗣(山梨大学), 見崎 大悟(工学院大)	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニズム, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニズム, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS, マイクロアクチュエータ, センサ, 光デバイス, マニピュレーションシステム, アセンブリングシステム, デザインシステム
H	03	OS	MEMS商業化技術	尹 成園(産総研), 小久保 光典(東芝機械), 村上 直(九州工業大), 藤野 真久(産総研), 岩崎 渉(産総研)	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス 作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント
H	04	OS	表面ナノ構造・ナノ計測	谷口 淳(東京理科大), 明田川 正人(長岡技科大), 遠藤 勝義(大阪大), 有馬 健太(大阪大)	ナノファブリケーション, ナノストラクチャー, プローブ顕微鏡
H	99	一般	ナノテクノロジー・新領域一般		

1) オーガナイズドセッションに申し込みをする場合は、講演を希望する分類・コード・セッション名を必ず選択してください。選択漏れ、選択ミスがありますとご希望のセッションにまわりませんのでご注意ください。なお、講演申込締切日を過ぎてからの講演希望セッションの変更はできません。

2) プログラム編成は、その編成権を学術交流委員会がもち、また責任をもって行います。その結果、ご希望のセッションとは異なるセッションでの発表になる場合もありますので、予めご承知おきください。また、プログラムは原則として変更できません。